



2009年3月期
中間決算説明会

(第2四半期累計)

2008年11月25日

ワイエイシー株式会社

(証券コード: 6298)

<http://www.yac.co.jp>



次 第

1. ご挨拶と会社概要・・・・・・・・・・・・ 代表取締役社長
百瀬 武文
2. 中間決算概要・・・・・・・・・・・・ 管理本部経理部長
古橋 博
3. 2009年3月期の予想・・・・・・・・・・・・ 代表取締役社長
百瀬 武文
4. 第10次中期計画の概要・・・・・・・・・・・・ 代表取締役社長
百瀬 武文
5. FEL事業の展望・・・・・・・・・・・・ 常務取締役
佐藤 康男
6. 質疑応答



本日のキーメッセージ

- 景気悪化が進行する中での現在の取組み
- 第10次中期計画(2010年3月期～12年3期)基本戦略
- FEL新事業の展望



1. 会社概要



1-1 基本情報

(2008年9月30日現在)

商 号	ワイエイシイ株式会社
証券コード	6298 (東証1部)
設 立	1973年 (昭和48年)年5月
代 表 者	代表取締役社長 百瀬武文
事業所等	本 社：東京都昭島市武蔵野3-11-10 営業所：大阪、大分、昭島、新竹（台湾）、上海（中国） 工 場：昭島、山梨、熊本
子 会 社	ワイエイシイ新潟精機株式会社（新潟県妙高市） HYAC Corporation（米国） YAC Systems Singapore Pte Ltd（シンガポール）
資 本 金	2,756百万円
事業内容	産業用エレクトロニクス関連装置、クリーニング関連装置の開発・製造・販売
決 算	3月31日



1-2 当社の主力製品

▲ハードデスク関連

- ・バニッシャー装置
- ・ワイピング装置
- ・クリーンコンベア

▲液晶関連

- ・プラズマ・ドライ・エッチング装置
- ・プラズマ・ドライ・アッシング装置
- ・アニール装置

▲半導体関連

- ・ロジック系IC用テストハンドラー

▲クリーニング関連

- ・自動包装機
- ・ワイシャツ仕上機
- ・アパレル

▲FEL関連

<ハードディスク関連製品>

バニッシャー	ハードディスク製造工程において、ディスクに磁性体を生成後、表面のナノオーダーの微小突起を除去する精密研磨装置
ワイピング	ハードディスク製造工程において、ディスクに磁性体を生成後、バニッシュ工程の前後で、表面のパーティクルの除去及び潤滑財を表面に均一にする装置
クリーンコンベア (HD工場向け)	モジュールの組み合わせで自由な搬送ライン設計が可能なローラー式コンベア。AGV(自走型搬送ロボット)やOHT(天井架設型搬送装置)に比べ、搬送物をいつでも搬送ラインに投入することができ、搬送効率が高い。
クリーンコンベア (半導体工場向け、 太陽電池工場向け)	(同上)但し、半導体向けは搬送物が300mm用ウエハポット、太陽電池はガラス基板又は約5"ウエハーが入ったカセットで、ハードディスク用に比べコンベア幅大きく、より高い耐加重性、耐衝撃性、高速搬送が要求される。
クリーンコンベア (液晶工場向け)	(同上)但し、搬送物はパネルサイズに切りだされた基盤を搬送する、ハードディスク用に比べコンベア幅大きく、より高い耐加重性、耐衝撃性、高速搬送が要求される。



バニッシャー



ハードディスク用クリーンコンベア



半導体用クリーンコンベア

<液晶関連製品>

<p>プラズマ・ドライ・エッチング装置</p>	<p>液晶ディスプレイの各セルの液晶整列方向を個々に制御する微小トランジスターをガラス基板上に描画するプロセスで用いる。 フォトマスクを通して露光した結果、硬化した部分以外を除去後、露出した薄膜をプラズマを利用してガス化し除去する装置。</p>
<p>アニール装置</p>	<p>ガラス表面に塗布された半導体膜の結晶化と不純物の活性化を行う装置。</p>



第7世代用プラズマ・ドライ・エッチング装置(3チャンバータイプ)

対応 基板サイズ
G2
G4
G4.5
G5
G5.5
G6
G7
G7.5
G8

<半導体関連製品>

ロジック系IC用
ICテストハンドラー

ICのパッケージング後の検査工程で、テスターと接続して使用し、テスターからのテスト結果信号に基づき、ICを良品と不良品に自動選別する装置。
必要に応じて、精度の高い高温・低温(-55°C~155°C)下でのテストも行う。



ICテストハンドラー(4個同時測定・常温タイプ)



新製品 ICテストハンドラー(16個同時測定・常・高温タイプ)

<クリーニング関連製品>

ボディープレス機	シャツを前後から熱版ではさみシャツのボディー部をプレスする装置。 胴立を2つもち、プレス中に次のシャツを装填できるダブルタイプと、胴立がひとつのシングルタイプがある。 またプレス完了のシャツを自動でハンガーの掛けるオートキャリー付のタイプもあり。
タック・スリーブプレス機	シャツのタック部・袖部のプレス機(ダブルタイプ・シングルタイプ)
カラー・カフスプレス機	シャツの襟部・カフス部のプレス機(ダブルタイプ・シングルタイプ)
包装機	クリーニング完了後の衣類にカバーフィルムを自動で装填する装置。 ハンガーのままカバーする立体タイプとたたんだ状態でカバーする平面タイプがある。
アパレル関連機械	洋服の生産工程、縮絨機(生地を蒸気で安定化させる)、芯地・接着機(裁断後の生地を張り合わせる) プレス仕上げ機(完成商品のシワを取り成型する)



シャツ用ボディープレス機
(Wタイプ・オートキャリー付)



包装機 (立体タイプ)



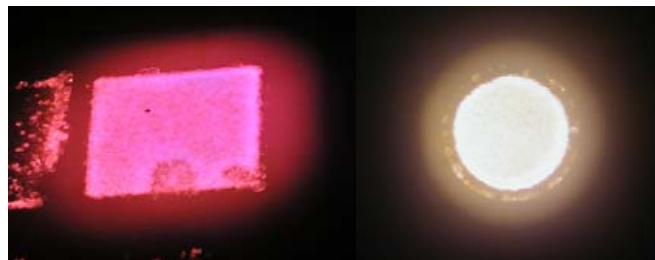
縮絨機



仕上げ機

<FEL関連商品>

ナノダイヤモンド薄膜製造	<p>金属等の材料の表面にナノダイヤモンドの薄膜を生成したエミッターを製作。</p> <p>特徴（ナノダイヤモンド薄膜を使用したランプ）</p> <ul style="list-style-type: none">・従来の蛍光灯と異なり、水銀・鉛等の有害物質を使用しない。・LED（発光ダイオード）に比べ発光効率が高く省エネ効果がある。・蛍光灯に比べ長寿命である。・蛍光灯、LEDに比べ発熱量が少ない。・色合成の自由度が高い。
--------------	---



発光写真



2. 中間決算概要



2-1 決算のハイライト(連結)

単位 百万円

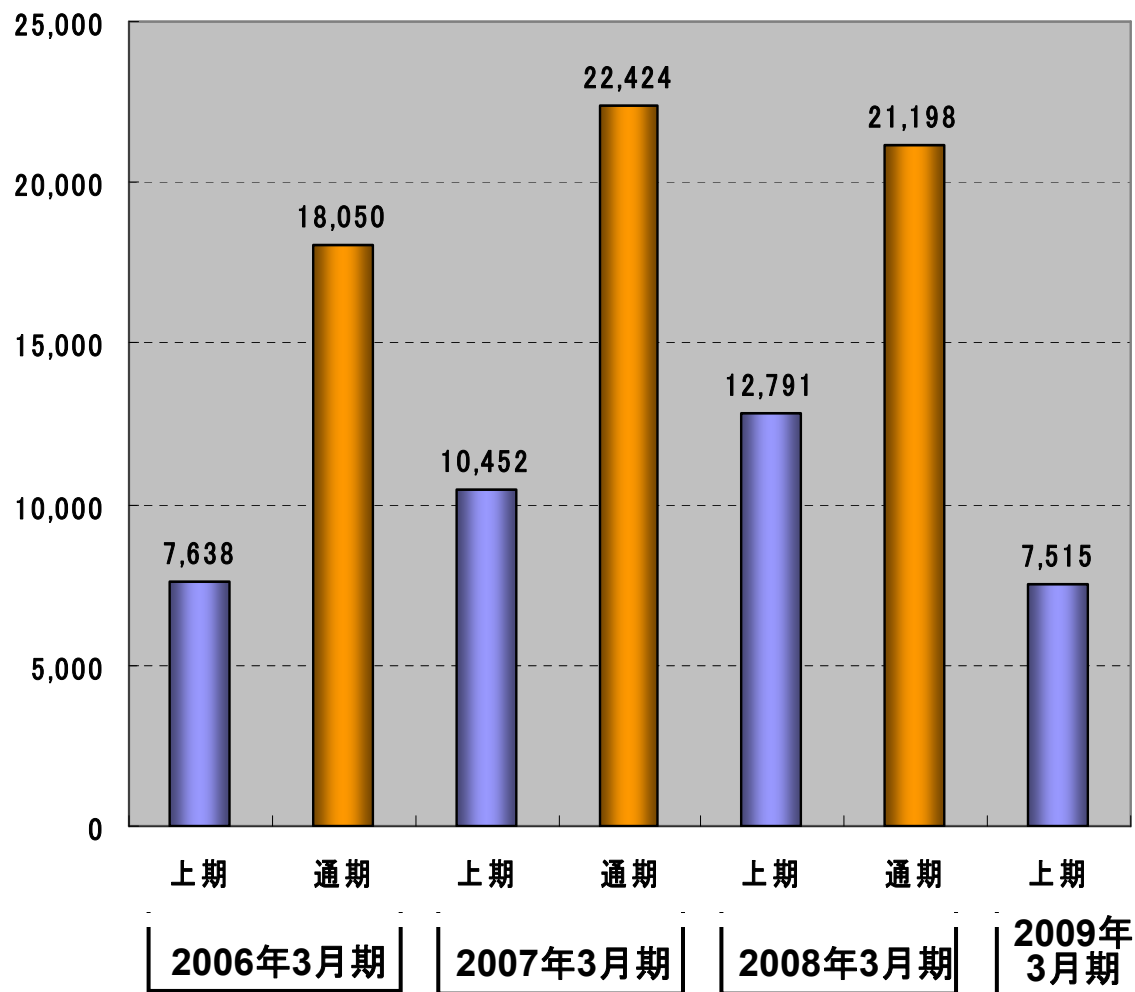
科目	2007年3月期(実績)		2008年3月期(実績)		2009年3月期		中間期 前年同期比 増減額	中間期 前年同期比 増減率(%)
	中間	通期	中間	通期	中間(実績)	通期(見込)		
売上高	10,452	22,424	12,791	21,198	7,515	13,500	▲5,276	▲41.2%
メモリーデスク	5,048	9,899	4,383	7,040	1,663	3,000	▲2,720	▲62.1%
液晶	3,911	9,400	6,995	10,919	4,073	7,500	▲2,922	▲41.8%
半導体	866	1,404	469	1,093	956	1,200	487	103.8%
クリーニング [※]	627	1,721	944	2,146	823	1,790	▲120	▲12.7%
FEL	—	—	—	—	0	10	0	—
営業利益	1,709	3,676	1,597	2,295	530	640	▲1,067	▲66.8%
経常利益	1,694	3,584	1,586	2,372	563	650	▲1,023	▲64.5%
当期利益	1,095	2,103	1,038	1,524	327	390	▲711	▲68.5%
1株当たり当期利益	114.7	219.1	107.5	158.1	35.1	41.9	▲72.4	▲67.3%
営業利益率	16.3%	16.4%	12.5%	10.8%	7.1%	4.7%	—	—
研究開発費	93	237	136	287	153	—	17	12.5%
設備投資額	41	52	179	213	13	—	▲166	▲92.7%
減価償却実施額	79	160	67	148	87	—	20	29.9% ¹⁾



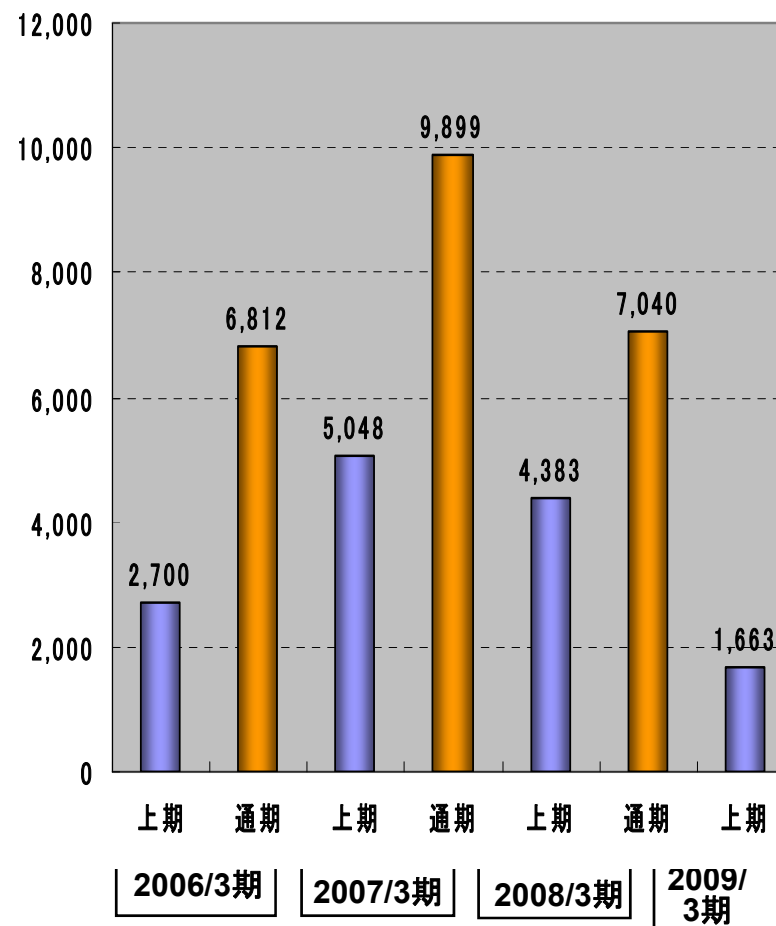
2-2 事業別売上金額(連結)

単位 百万円

全社



メモリーデスク関連

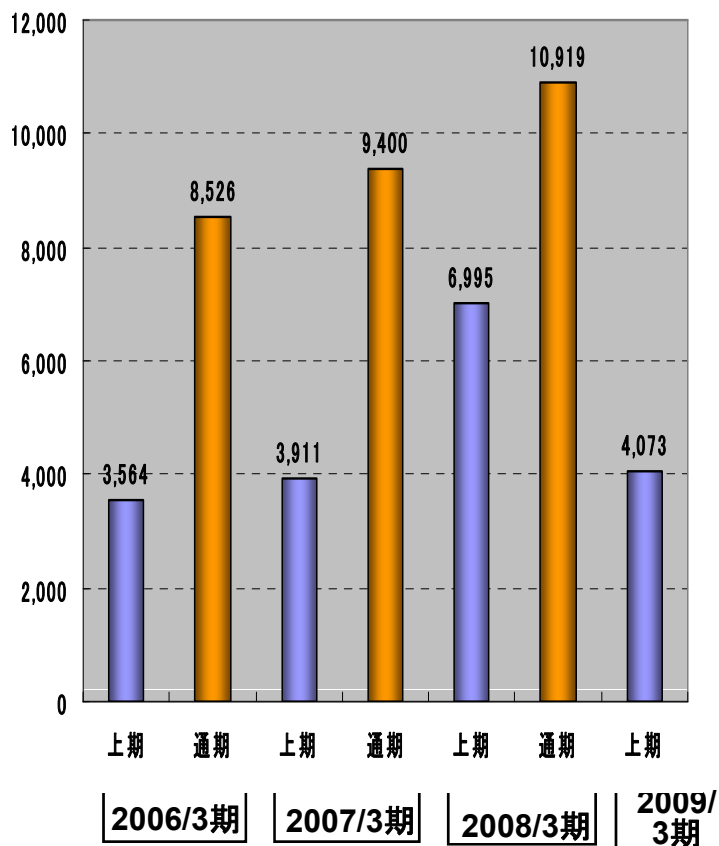




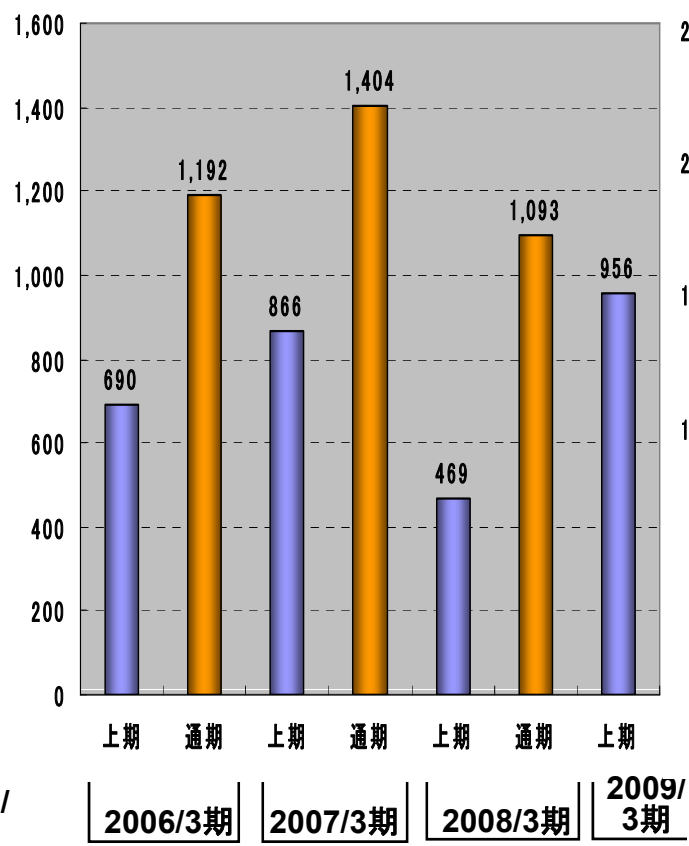
2-2 事業別売上金額(連結)

単位 百万円

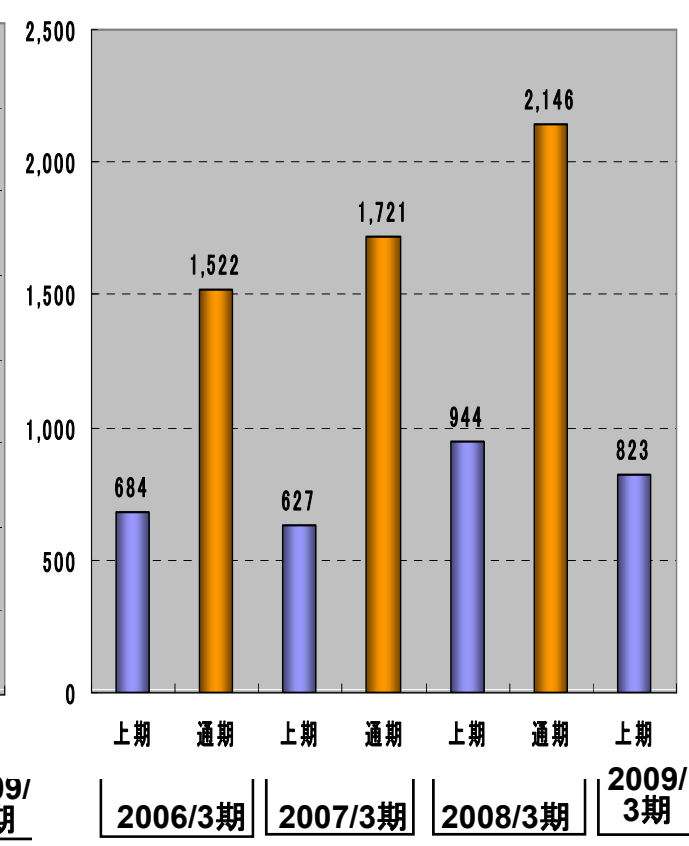
液晶関連



半導体関連



クリーニング関連





2-3 事業別受注金額(連結)

単位 百万円

科目	2007年3月期 中間	2008年3月期 中間	2009年3月期 中間	前年同期比 増減額	前年同期比 増減率(%)
メモリーディスク関連	5,782	3,330	1,491	▲1,839	▲55.2%
液晶関連	8,475	1,469	5,112	3,643	248.0%
半導体関連	897	452	676	224	49.6%
FEL	—	—	0	—	—
クリーニング関連	627	944	823	▲121	▲12.8%
合計	15,781	6,195	8,102	1,907	30.8%

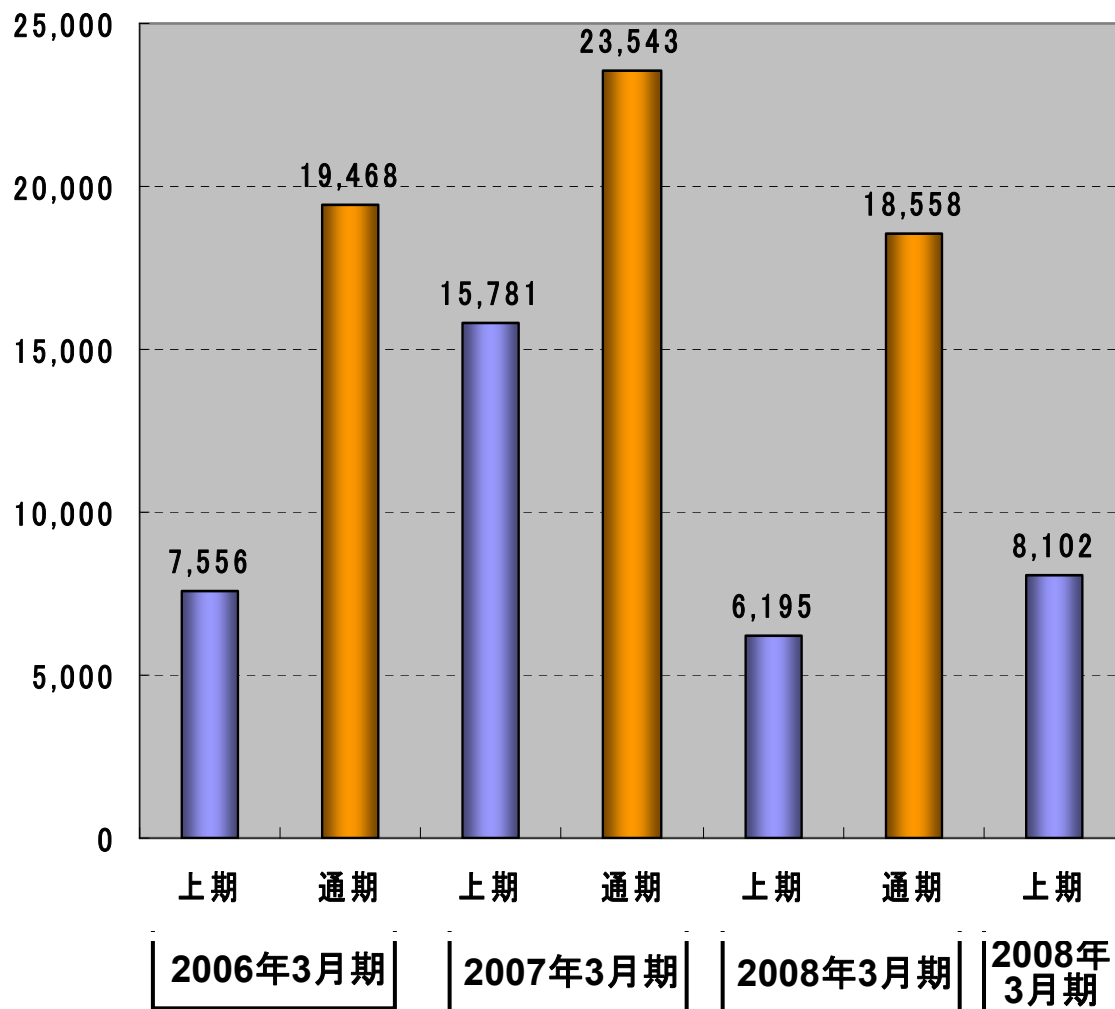
クリーニング関連は、販売計画に基づいた見込み生産をしておりますので受注=売上となります、



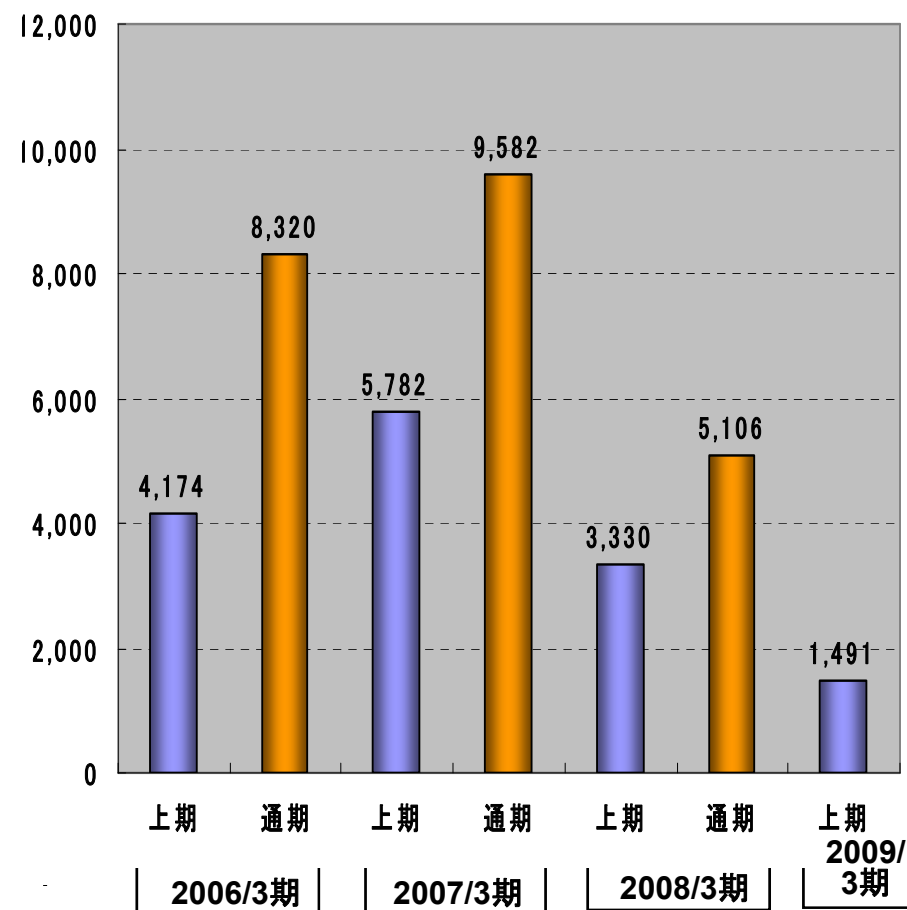
2-3 事業別受注金額(連結)

単位 百万円

全社



メモリーデスク関連

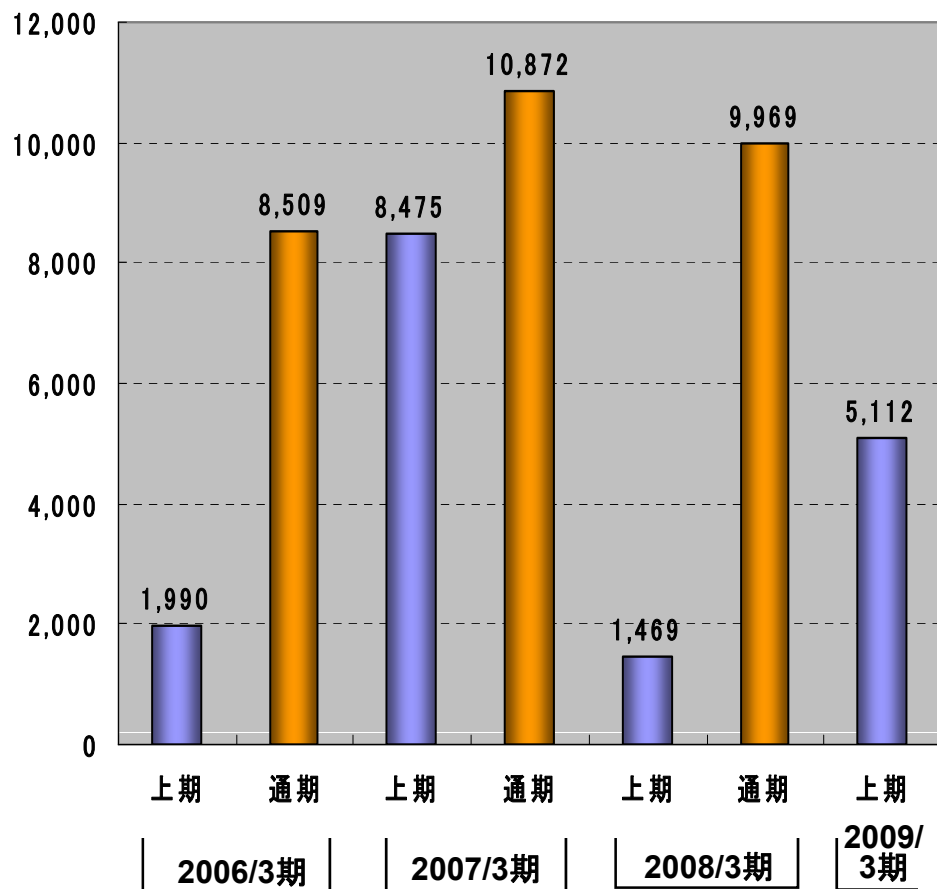




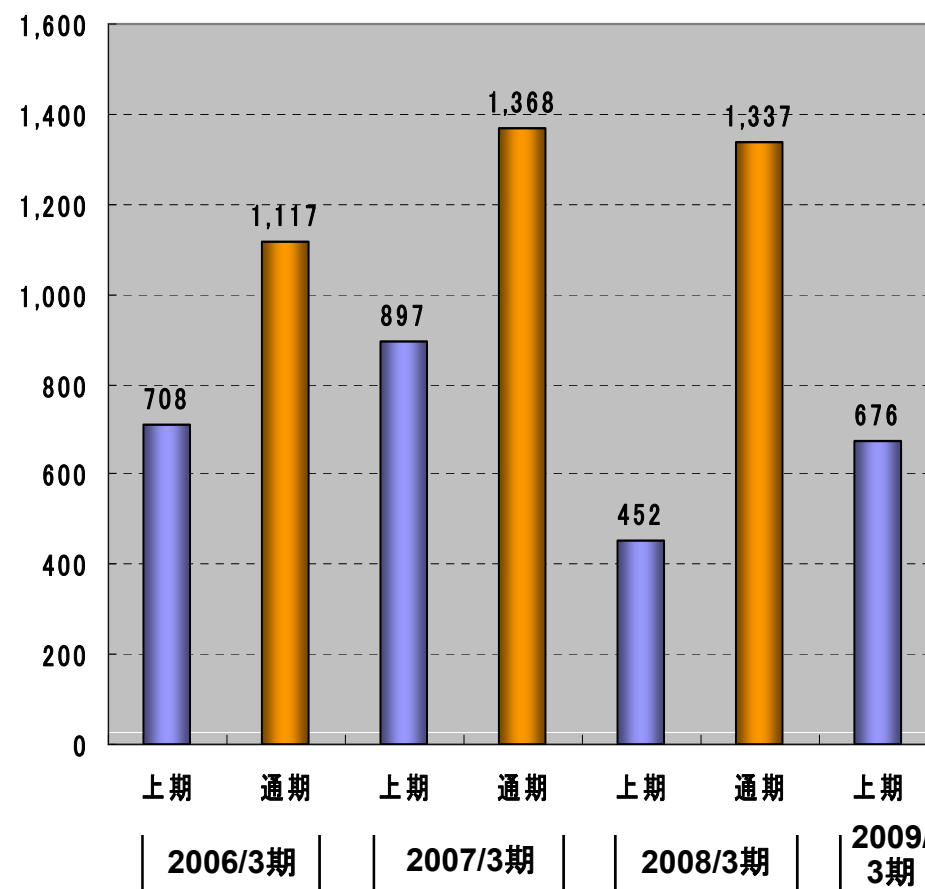
2-3 事業別受注金額(連結)

単位 百万円

液晶関連



半導体関連



クリーニング関連は、売上データと同一ですので、そちらをご覧ください



2-4 事業部別受注残金額(連結)

単位 百万円

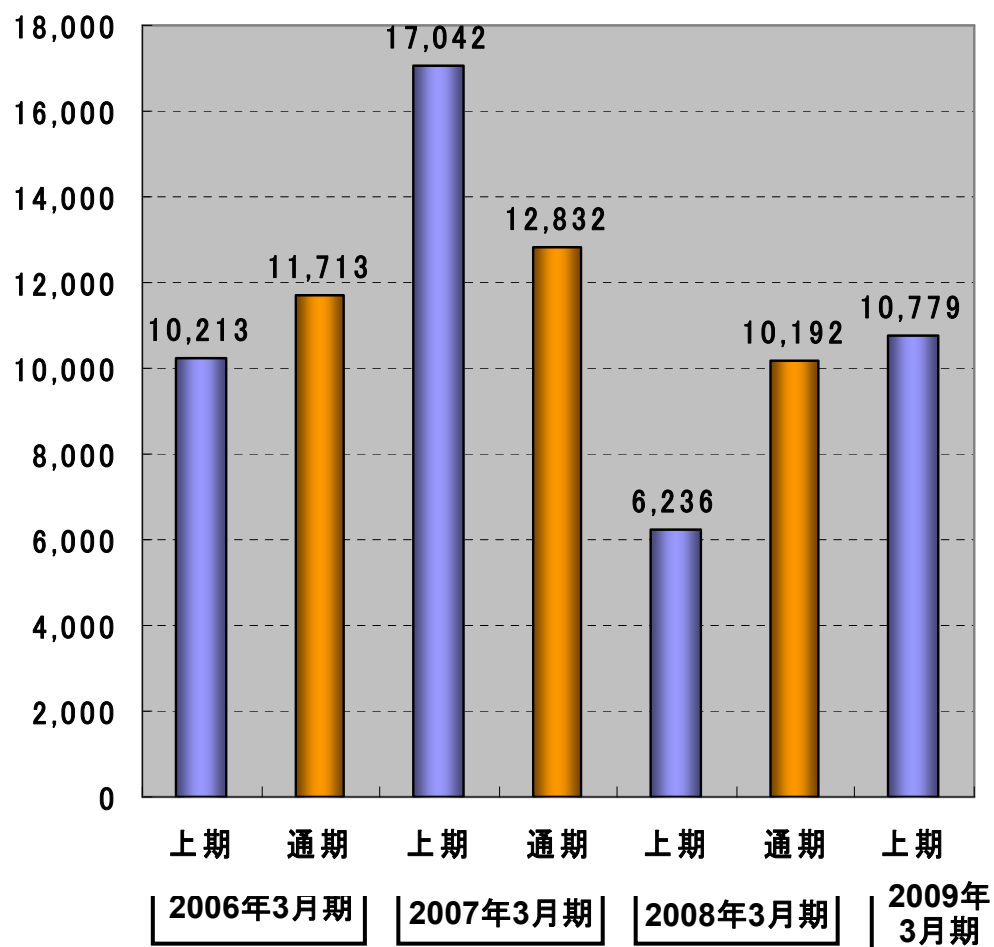
科目	2007年3月期 中間	2008年3月期 中間	2009年3月期 中間	前年同期比 増減額	前年同期比 増減率(%)
メモリーデスク関連	3,846	1,743	690	▲1,053	▲60.4%
液晶関連	12,971	4,353	9,967	5,614	129.0%
半導体関連	225	140	121	▲19	▲13.6%
FEL	—	—	0	—	—
クリーニング関連	—	—	—	—	—
合計	17,042	6,236	10,779	4,543	72.9%



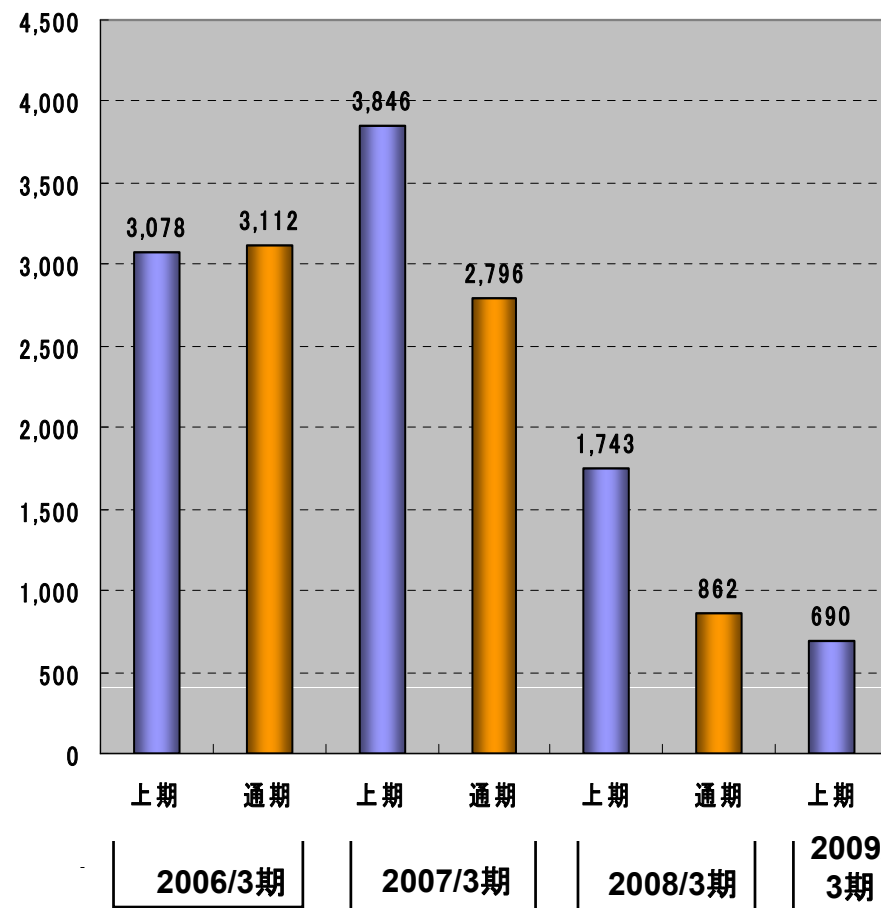
2-4 事業部別受注残金額(連結)

単位 百万円

全社



メモリーデスク関連

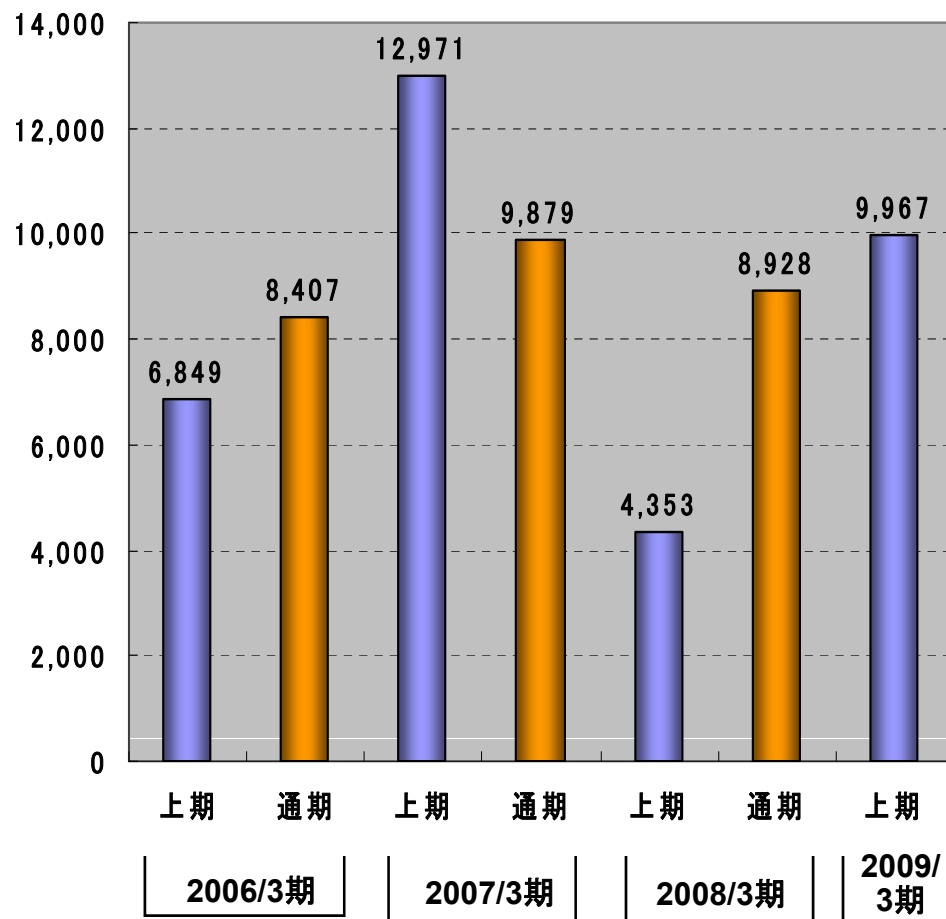




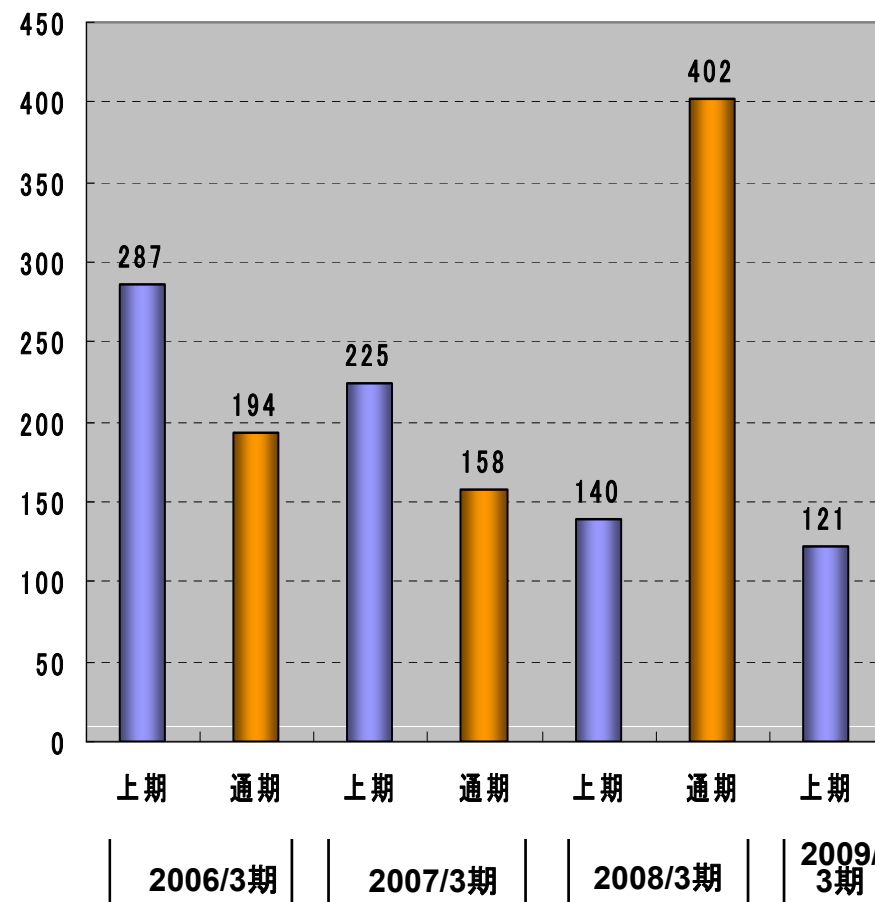
2-4 事業部別受注残金額(連結)

単位 百万円

液晶関連



半導体関連





損益計算書のレビュー

(単位:百万円)

科目	2006年 3月期	2007年 3月期	2008年 3月期	2006年 9月中間期	2007年 9月中間期	2008年 9月中間期	前年同期比 増減率(%)
売上高	18,050	22,424	21,198	10,452	12,791	7,515	▲ 41.2
売上原価	13,779	16,711	16,694	7,821	10,095	5,864	
売上総利益	4,272	5,713	4,504	2,631	2,696	1,650	▲ 38.8
販管費	1,776	2,037	2,209	922	1,099	1,120	
営業利益	2,495	3,676	2,295	1,709	1,597	530	▲ 66.8
営業外収益	42	73	169	40	41	68	
営業外費用	136	166	92	55	52	35	
経常利益	2,402	3,584	2,372	1,694	1,586	563	▲ 64.5
特別利益	6	9	6	6	5	13	
特別損失	94	118	3	9	0	0	
税引前当期純利益	2,314	3,475	2,375	1,691	1,591	576	▲ 63.8
税金費用	808	1,372	851	596	553	250	
当期純利益	1,505	2,103	1,524	1,095	1,038	327	▲ 68.5



貸借対照表のレビュー

(単位:百万円)

科目	2006年 3月期	2007年 3月期	2008年 3月期	2006年 9月中間期	2007年 9月中間期	2008年 9月中間期	前年同期末比 増減額
流動資産	16,122	20,638	18,236	19,108	19,343	16,459	▲ 2,884
現金預金	4,727	5,360	4,625	4,765	4,468	5,724	1,256
売上債権	7,122	7,471	9,218	8,257	9,538	6,513	▲ 3,025
棚卸資産	3,914	7,204	4,153	5,566	5,131	3,901	▲ 1,230
その他	359	603	240	520	206	321	115
固定資産	2,744	2,970	3,166	3,072	3,440	3,119	▲ 321
有形固定資産	2,494	2,661	2,828	2,712	2,806	2,813	7
無形固定資産	14	110	100	74	104	95	▲ 9
投資その他の資産	236	199	238	286	530	211	▲ 319
資産合計	18,866	23,608	21,402	22,180	22,783	19,578	▲ 3,205
流動負債	8,469	12,466	8,500	11,047	9,729	6,023	▲ 3,706
仕入債務	5,856	9,199	4,133	8,348	6,854	4,215	▲ 2,639
短期借入金	1,041	1,364	3,647	1,127	1,642	957	▲ 685
その他	1,572	1,903	720	1,572	1,233	851	▲ 382
固定負債	4,189	1,098	2,172	1,985	2,153	2,699	546
社債・長期借入金	3,808	610	1,622	1,508	1,435	2,134	699
その他	381	488	550	477	718	565	▲ 153
負債合計	12,658	13,564	10,672	13,032	11,882	8,722	▲ 3,160
純資産	6,208	10,044	10,730	9,148	10,901	10,856	▲ 45
負債純資産合計	18,866	23,608	21,402	22,180	22,783	19,578	▲ 3,205



キャッシュフロー計算書のレビュー

(単位:百万円)

科目	2006年 3月期	2007年 3月期	2008年 3月期	2006年 9月中間期	2007年 9月中間期	2008年 9月中間期
税引前当期純利益	2,314	3,475	2,375	1,691	1,591	576
減価償却費	207	160	148	79	67	87
引当金の増減額	17	9	25	12	9	▲6
売上債権の増減額	▲182	127	▲2,392	▲859	▲2,635	2,800
棚卸資産の増減額	▲1,072	▲3,235	2,912	▲1,579	2,048	198
仕入債務の増減額	▲919	3,245	▲5,077	2,419	▲2,342	109
法人税等の支払額	▲405	▲1,503	▲1,226	▲923	▲662	▲247
その他	55	▲183	412	▲147	386	▲73
営業活動によるCF	15	2,095	▲2,823	693	▲1,538	3,444
投資活動によるCF	418	▲91	▲306	▲85	▲266	▲5
財務活動によるCF	1,653	▲1,401	2,582	▲595	959	▲2,363
現金及び現金同等物に係る換算差額	60	6	▲167	3	▲25	21
現金及び現金同等物の増減	2,145	609	▲715	15	▲871	1,097
現金及び現金同等物の期末残高	4,727	5,336	4,621	4,742	4,465	5,718



3. 2009年3月期の予想



3-1 第9次中期計画の基本戦略

I T産業の特徴

1. 高成長 2. 競争激化 3. 高スピード（技術革新） 4. 市場変動（大きい）



この事業環境における安定的収益確保

ワイエイシイの基本戦略

1. 高収益企業への挑戦	<ul style="list-style-type: none">・オンリーワン技術の強化（差別化）・依命システムの徹底・低コスト経営の徹底・モチベーションの一層の高揚
2. マーケット深耕	<ul style="list-style-type: none">・顧客との強固な信頼関係構築による市場ニーズの先取りにより新製品バージョンUPによる差別化、取扱製品の増加
3. ファブレス経営の徹底	<ul style="list-style-type: none">・営業、開発、技術、アフターサービスを中心とした経営体制・市場変動による経営リスクの最小化
4. カスタマー・サポートの充実	<ul style="list-style-type: none">・顧客との強固な信頼関係構築による当社純正修理部品の利用推進と消耗品の拡大
5. M&A、アライアンス	<ul style="list-style-type: none">・シェアUPとシナジー効果による事業拡大
6. グローバル経営	<ul style="list-style-type: none">・グローバル化の更なる拡大
7. 環境対応	<ul style="list-style-type: none">・当社製品の環境への対応



3-2 事業環境(設備動向)

<ハードディスク市場>

- **ドライブの需要は用途の広がり等により年率10~15%の上昇が見込まれるが、業界再編等により設備投資は先送りされている。**
- **次世代高密度デスクの開発進められている。**

◎ **前年比 60%マイナス成長を予想**

<液晶パネル市場>

- **大型(TV用)、小型パネル(携帯端末)ともに生産調整に入っている、また設備投資も先送りされている。**
- **2010年、11年の地上波デジタル放送本格稼働まで潜在的設備投資の継続が見込まれる。**

◎ **前年比 30%マイナス成長を予想**



3-2 事業環境(設備動向)

<半導体市場>

- ・今年度後工程の需要が前半は増えたが後半は厳しい状況にある。

◎ 前年比 10%のプラス成長を予想

<クリーニング市場>

- ・国内、海外先進国での市場は成熟しているが。海外新興国の需要は徐々に拡大している。

◎ 前年比 20%のマイナス成長を予想

<FEL市場>

- ・テストサンプル提供、来期には事業化へ



3-3 景気悪化が進行する中での、現在の取組み

1・景気悪化の影響を受ける度合いを少なくする施策

- ① トップの胆力、事業に対する情熱と使命感
- ② 全従業員の危機感の共有
- ③ 受注拡大（営業戦略の変更、アライアンス）
- ④ 粗利UP（生産コスト、外注・仕入れコスト、低コスト設計）
- ⑤ 経営コストの低減（人件費、経費、設備投資）

2・景気回復時に一段と飛躍する施策の実行

- ① シェアUP（差別化、アライアンス、M&A）
- ② 取扱製品の増加（開発、アライアンス、M&A）
- ③ グローバル展開の拡大
- ④ 人材育成



3-4 2009年3月期 通期計画(連結)

単位 百万円

科目	2006年 3月期	2007年 3月期	2008年 3月期	2009年 3月期 (見込)			前年比 増減額 (見込)	前年比 増減率 (%) (見込)
	実績	実績	実績	(上期) 実績	(下期) 見込	(通期) 見込		
売上高	18,050	22,424	21,198	7,515	5,985	13,500	▲7,698	▲36.3%
営業利益	2,495	3,676	2,295	530	110	640	▲1,655	▲72.1%
経常利益	2,402	3,584	2,372	563	87	650	▲1,722	▲72.6%
当期純利益	1,505	2,103	1,524	327	63	390	▲1,134	▲74.4%
1株当たり当期純利益 (円)	167.8	219.1	158.1	35.1	6.8	41.9	▲116.2	▲73.5%



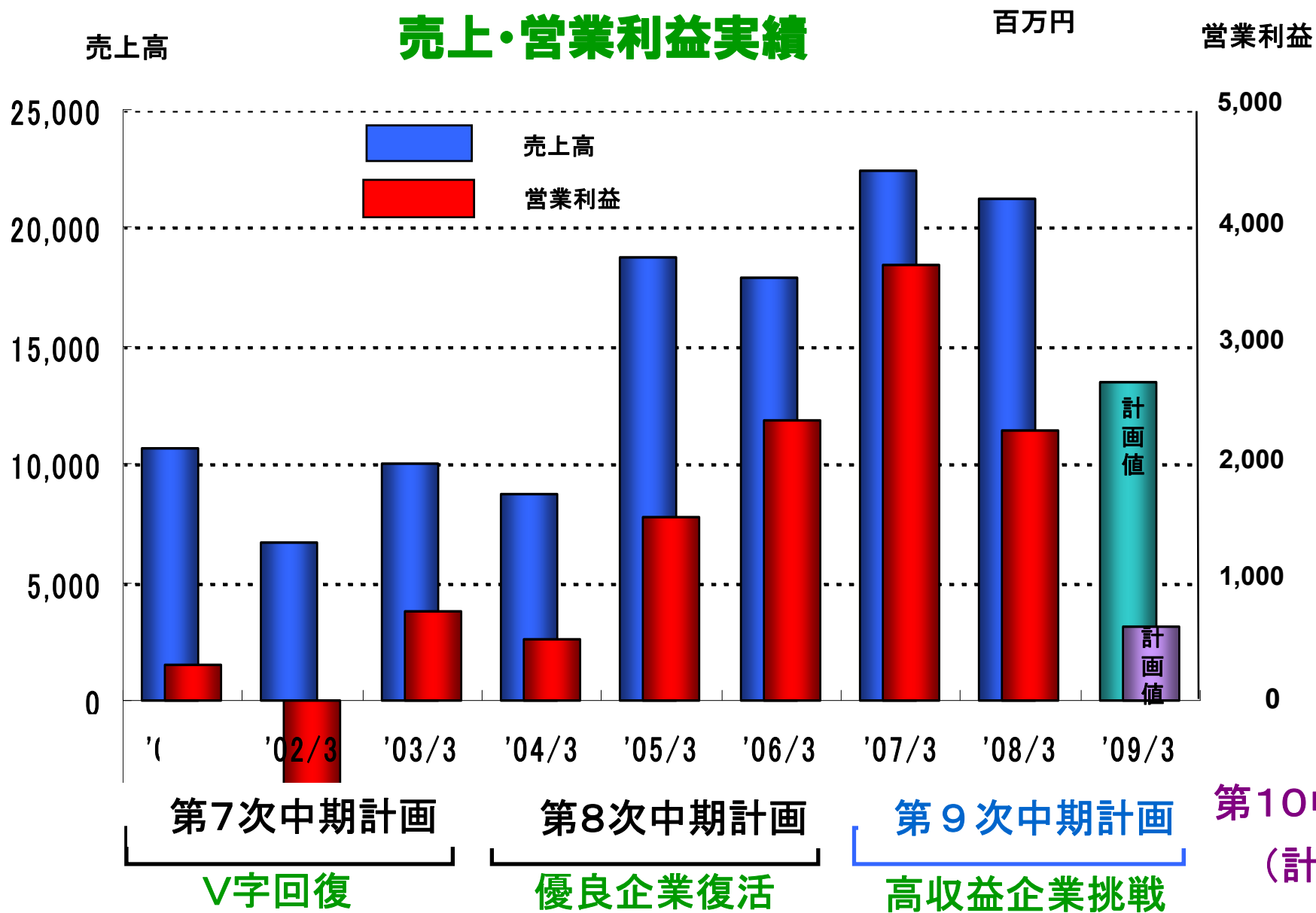
3-5 2009年3月期 事業別売上計画(連結)

単位 百万円

科目	2006年 3月期	2007年 3月期	2008年 3月期	2009年 3月期 (見込)			前年比 増減額 (見込)	前年比 増減率(%) (見込)
				(上期) 実績	(下期) 見込	(通期) 見込		
メモリーディスク関連	6,811	9,899	7,040	1,663	1,337	3,000	▲4,040	▲57.4%
液晶関連	8,525	9,400	10,919	4,073	3,427	7,500	▲3,419	▲31.3%
半導体関連	1,192	1,404	1,093	956	244	1,200	107	9.8%
クリーニング関連	1,522	1,721	2,146	823	967	1,790	▲356	▲16.6%
FEL関連	—	—	—	0	10	10	10	—
売上合計	18,050	22,424	21,198	7,515	5,985	13,500	▲7,698	▲36.3%



3-6 業績推移と第9次中期計画 (連結)



4. 第10次中期計画の概要



4-1 第10次中期計画の概要

1・経営の基本方針

- (1) 高収益企業文化の構築
- (2) 規模の拡大
- (3) ソリューション型研究開発企業
- (4) マーケット深耕
- (5) CSR経営

2・経営目標

- (1) 売上
- (2) 営業利益率



4-1 第10次中期計画の概要

3・経営目標達成への事業戦略

- (1) 主力製品のシェアアップ
- (2) 取扱製品の増加
- (3) グローバル展開の拡大
- (4) サービス事業の拡大

4・新製品（開発中）の早期事業化

5・M&Aによる事業の拡大

5. FEL事業の展望

FELの特徴と長所を生かした応用分野へ

FELの特徴

1. 水銀レス
→低負荷環境型
2. 高輝度
・高発光効率
→省エネルギー
4. 低温駆動
→冷却レス

FELの応用分野



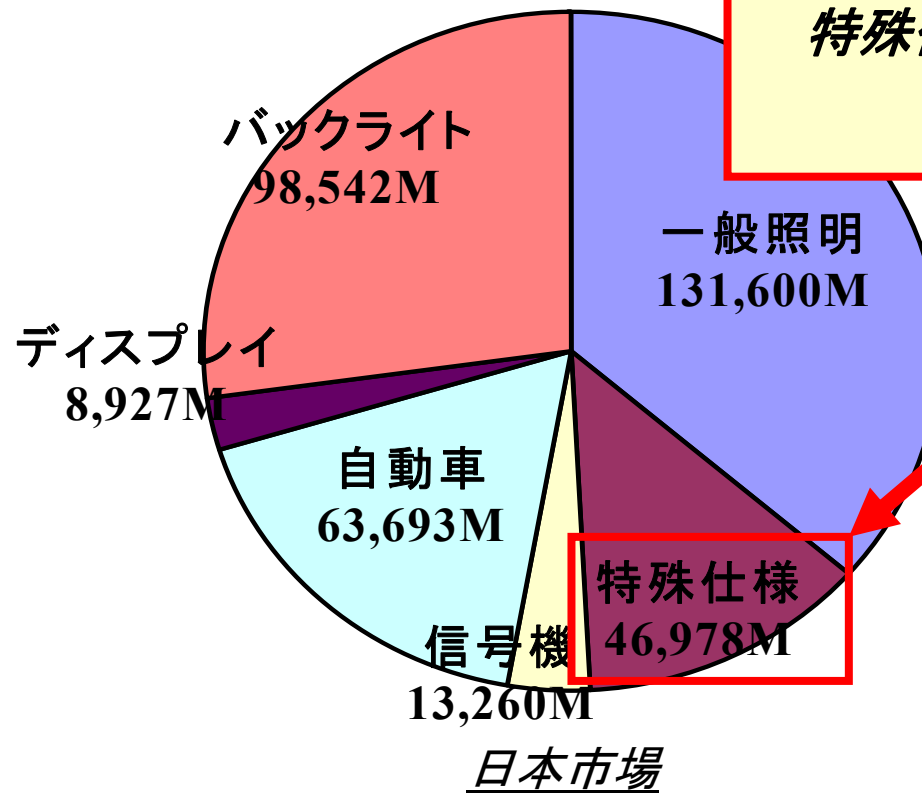
軟X線源→除電
電子線源→樹脂硬化・殺菌・表面改質

写真はイメージであり本製品とは関係ありません。



Lampの応用マーケット

2008年世界市場予測 3,700B円 (国内統計 363,000M円)



第10次中期計画のTarget

特殊仕様Lamp市場への供給

4%を狙う

注意事項

本資料には、ワイエイシイの業績等に関する記述が含まれておりますが、これらの記述は、現時点で入手可能な情報および将来の業績に影響を与える不確実な要因にかかる現時点における仮定を前提としています。従いまして、これらの記述は、将来実現する保証はなく、実際の結果と異なる可能性があることをご承知おきください。

なお、実際の業績に影響を与える要因には、経済情勢、製品の需要動向、資材価格、為替レートならびに金利の動向等が含まれますが、これらに限定されるものではありません。

ワイエイシイ株式会社